


Dell EMC PowerEdge R6515

Caractéristiques techniques

Remarques, précautions et avertissements

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

 **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

Table des matières

Chapitre 1: Caractéristiques techniques.....	4
Dimensions du châssis.....	5
Poids du système.....	6
Spécifications du processeur.....	6
Spécifications des blocs d'alimentation (PSU).....	6
Systèmes d'exploitation pris en charge.....	6
Caractéristiques des ventilateurs de refroidissement.....	7
Caractéristiques de la pile du Système.....	7
Caractéristiques des cartes de montage de cartes d'extension.....	7
Spécifications de la mémoire.....	7
Caractéristiques du contrôleur de stockage.....	8
Caractéristiques du disque.....	8
Disques.....	8
Lecteurs optiques.....	8
Spécifications des ports et connecteurs.....	9
Caractéristiques des ports USB.....	9
Caractéristiques de la carte de montage LOM.....	9
Caractéristiques du connecteur série.....	9
Caractéristiques des ports VGA.....	9
IDSDM.....	9
Spécifications vidéo.....	10
Spécifications environnementales.....	10
Caractéristiques de contamination de particules et gazeuse.....	11
Tableau des restrictions thermiques.....	12

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques et environnementales de votre système sont énoncées dans cette section.

Sujets :

- Dimensions du châssis
- Poids du système
- Spécifications du processeur
- Spécifications des blocs d'alimentation (PSU)
- Systèmes d'exploitation pris en charge
- Caractéristiques des ventilateurs de refroidissement
- Caractéristiques de la pile du Système
- Caractéristiques des cartes de montage de cartes d'extension
- Spécifications de la mémoire
- Caractéristiques du contrôleur de stockage
- Caractéristiques du disque
- Spécifications des ports et connecteurs
- Spécifications vidéo
- Spécifications environnementales

Dimensions du châssis

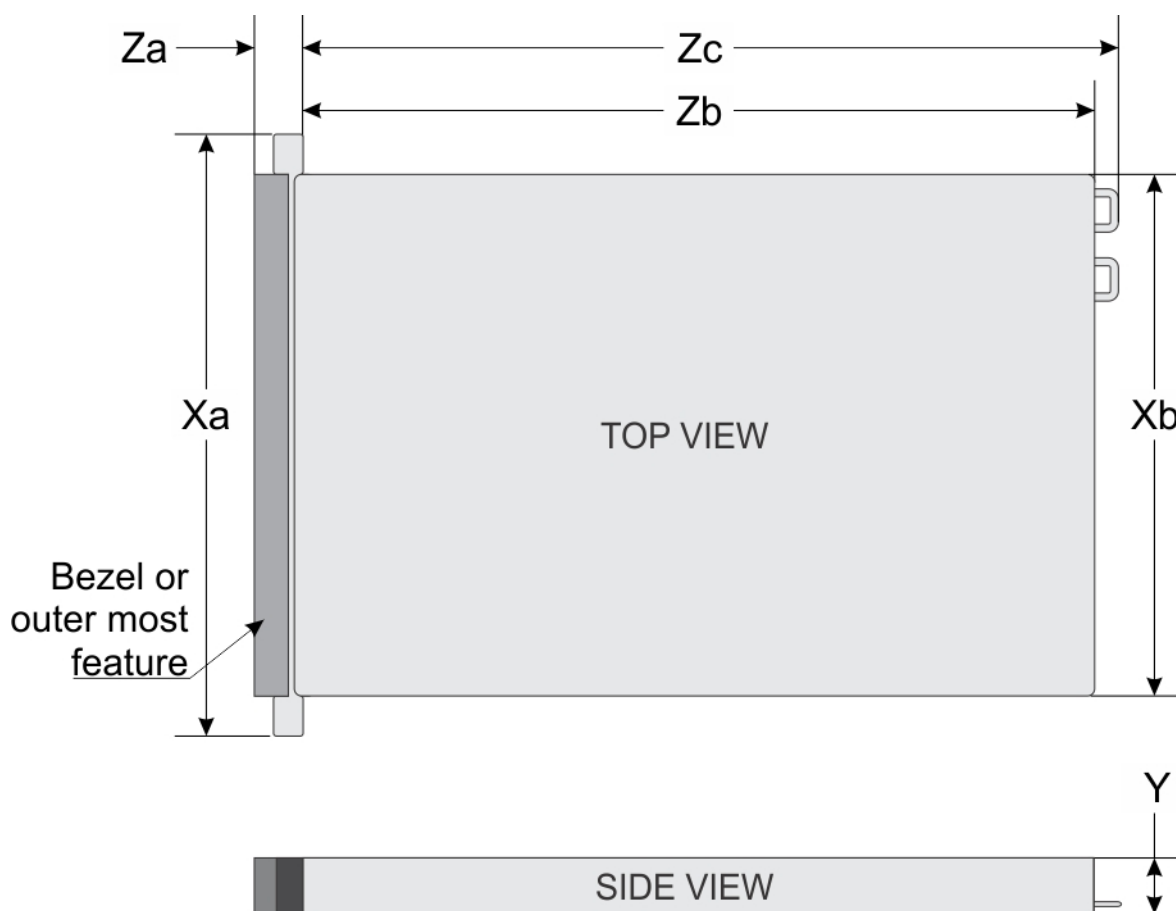


Figure 1. Dimensions du châssis

Tableau 1. Dimensions du châssis PowerEdge R6515

Configurations du système	Xa	Xb	Y	Za	Zb*	Zc
4 disques 3,5 pouces ou 10 disques 2,5 pouces	482 mm (18,97 pouces)	434 mm (17,08 pouces)	42,8 mm (1,68 pouce)	Avec le cadre : 35,84 mm (1,4 pouce) Sans le cadre : 22 mm (0,87 pouce)	657,25 mm (25,87 pouces)	692,62 mm (27,26 pouces)
8 disques 2,5 pouces	482 mm (18,97 pouces)	434 mm (17,08 pouces)	42,8 mm (1,68 pouce)	Avec le cadre : 35,84 mm (1,4 pouce) Sans le cadre : 22 mm (0,87 pouce)	606,47 mm (23,87 pouces)	641,85 mm (25,26 pouces)

REMARQUE : * La distance Zb est mesurée jusqu'à la surface externe de la paroi arrière nominale où se trouvent les connecteurs d'E/S de la carte mère.

Poids du système

Tableau 2. Poids du système PowerEdge R6515

Configuration du Système	Poids maximal (avec tous les disques)
Configuration à 4 disques de 3,5 pouces	16,75 kg (36,92 lb)
Configuration à 8 disques de 2,5 pouces	15,6 kg (34,39 livres)
Configuration à 10 disques de 2,5 pouces	15,8 kg (34,83 lb)

Spécifications du processeur

Tableau 3. Spécifications du processeur du système PowerEdge R6515

Processeur pris en charge	Nombre de processeurs pris en charge
Processeur AMD EPYC séries 7002 et 7003	un

Spécifications des blocs d'alimentation (PSU)

Tableau 4. Spécifications des blocs d'alimentation du système PowerEdge R6515

Bloc d'alimentation	Classe	Dissipation thermique (maximale)	Fréquence	Tension	Actuel
550 W CA	Platinum	2 107 BTU/h	50/60 Hz	100-240 V CA, sélection automatique	7,4 A - 3,7 A
700 W CA	Platinum	2 107 BTU/h	50/60 Hz	100-240 V CA, sélection automatique	7,4 A - 3,7 A

REMARQUE : Ce système est également conçu pour se connecter aux systèmes d'alimentation informatiques avec une tension phase à phase ne dépassant pas 230 V.

REMARQUE : Pour certaines configurations premium avec une consommation élevée, les blocs d'alimentation du système peuvent uniquement rester en mode 2+0, car le mode redondant 1+1 n'est pas disponible.

REMARQUE : Lorsque vous sélectionnez ou mettez à niveau la configuration de votre système, vérifiez sa consommation électrique avec Dell Energy Smart Solution Advisor (Dell.com/ESSA) pour vous assurer une utilisation optimale de l'alimentation.

Systèmes d'exploitation pris en charge

Le système PowerEdge R6515 prend en charge les systèmes d'exploitation suivants :

- Canonical Ubuntu Server LTS
- Citrix Xen Hypervisor
- Microsoft Windows Server avec Hyper-V
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware vSAN/ESXi

Pour plus d'informations, voir le site www.dell.com/ossupport.

Caractéristiques des ventilateurs de refroidissement

Le système PowerEdge R6515 prend en charge à la fois le ventilateur standard (ventilateur STD) et le ventilateur hautes performances (ventilateur HPR). Il est nécessaire d'installer les six ventilateurs.

REMARQUE : L'utilisation simultanée des ventilateurs STD et HPR n'est pas prise en charge.

REMARQUE : L'installation des ventilateurs STD et HPR dépend de la configuration du système. Pour plus d'informations sur la configuration ou la prise en charge des ventilateurs, voir le [Tableau des restrictions thermiques](#).

Caractéristiques de la pile du Système

Le système PowerEdge R6515 prend en charge une pile bouton au lithium CR 2032 de 3 V comme batterie système.

Caractéristiques des cartes de montage de cartes d'extension

AVERTISSEMENT : Aucun processeur graphique grand public ne doit être installé ou utilisé dans les produits Enterprise Server.

Le système PowerEdge R6515 prend en charge jusqu'à deux cartes d'extension PCI Express (PCIe) :

Tableau 5. Logements de carte d'extension pris en charge sur la carte système

Logement PCIe	Carte de montage	Hauteur du logement PCIe	Longueur du logement PCIe	Largeur du logement
Logement 2	Carte de montage 1A	Mi-hauteur	Demi-longueur	x16 (3e génération)
Logement 3	Carte de montage 2	Mi-hauteur	Demi-longueur	x16 (4e génération)

Spécifications de la mémoire

Le système PowerEdge R6515 prend en charge les spécifications de mémoire suivantes pour un fonctionnement optimal.

Tableau 6. Spécifications de la mémoire

Type de barrette DIMM	Rangée DIMM	Capacité DIMM	RAM minimale	RAM maximale
Barrette RDIMM	Une rangée	8 Go	8 Go	128 Go
	Double rangée	16 Go	16 Go	256 Go
		32 Go	32 Go	512 Go
		64 Go	64 Go	1 To
3DS LRDIMM	Huit rangées	128 Go	128 Go	2 To

REMARQUE : L'ancienne mémoire RDIMM de 32 Go de capacité avec largeur de données x4 et densité DRAM de 8 Go ne peut être combinée avec la mémoire RDIMM de capacité 32 Go la plus récente avec une largeur de données x8 et une densité de DRAM de 16 Go dans la même unité de processeur AMD EPYC™.

REMARQUE : L'ancienne mémoire LRDIMM de 128 Go à une vitesse de 2 666 MT/s ne peut être combinée avec la nouvelle mémoire LRDIMM de capacité de 128 Go à une vitesse de 3 200 MT/s.

Tableau 7. Sockets de module de mémoire

Sockets de module de mémoire	Vitesse
Seize à 288 broches	3 200 MT/s, 2 933 MT/s, 2 666 MT/s

Caractéristiques du contrôleur de stockage

Le système PowerEdge R6515 prend en charge les cartes contrôleur suivantes :

Tableau 8. Cartes contrôleur du système PowerEdge R6515

Contrôleurs internes	Contrôleurs externes :
<ul style="list-style-type: none">• PERC H740P• PERC H730P• PERC H330• S150• HBA330• Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S1) : 2 SSD M.2 HWRAID	<ul style="list-style-type: none">• HBA SAS 12 Gbit/s HBA• H840• HBA355e

Caractéristiques du disque

Disques

Le PowerEdge R6515 système prend en charge :

- Jusqu'à 4 disques SAS, SATA ou SSD de 3,5 pouces accessibles à l'avant dans les logements 0 à 3
- Jusqu'à 8 disques SAS, SATA ou SSD de 2,5 pouces accessibles à l'avant dans les logements 0 à 7
- Jusqu'à 10 disques de 2,5 pouces accessibles à l'avant (dont 8 disques SAS/SATA dans les logements 0 à 7 + 2 disques NVMe dans les logements 8 à 9)
- Jusqu'à 10 disques NVMe de 2,5 pouces accessibles à l'avant dans les logements 0 à 9

REMARQUE : Les disques NVMe accessibles à l'avant utilisent actuellement PCIe Gen 3.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'échange à chaud des disques SSD NVMe PCIe U.2, voir le *Dell Express Flash NVMe PCIe SSD User's Guide (Guide de l'utilisateur des disques SSD Dell Express Flash NVMe PCIe)* sur <https://www.dell.com/support>
> **Parcourir tous les produits** > **Infrastructure de datacenter** > **Adaptateurs et contrôleurs de stockage** > **Disques SSD Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCIe** > **Documentation** > **Manuels et documents.**

Lecteurs optiques

Le système PowerEdge R6515 prend en charge les lecteurs optiques suivants :

Tableau 9. Type de lecteurs optiques pris en charge

Type de disques pris en charge	Nombre de disques pris en charge
Lecteur DVD-ROM SATA dédié ou lecteur DVD+/-RW	un

Spécifications des ports et connecteurs

Caractéristiques des ports USB

Tableau 10. Spécifications des ports USB du système PowerEdge R6515

Avant		Arrière		Interne	
Type de port USB	Non. de ports	Type de port USB	Non. de ports	Type de port USB	Non. de ports
Port de type USB 2.0	un	Port de type USB 3.0	Deux	Port interne USB 3.0	un
Port de type micro USB 2.0 pour iDRAC direct	un				

REMARQUE : Le port de type micro USB 2.0 peut uniquement être utilisé comme un port iDRAC direct ou un port de gestion.

Caractéristiques de la carte de montage LOM

Le système PowerEdge R6515 prend en charge jusqu'à deux ports de contrôleur d'interface réseau (NIC) de 10/100/1 000 Mbit/s sur le panneau arrière. Le système prend également en charge la carte LOM sur une carte de montage (en option).

Vous pouvez installer une carte de montage LOM. Les options de carte de montage LOM prises en charge sont les suivantes :

- 2 x 1 Gb Base-T
- 2 x 10 Gb Base-T
- 2 x 10 Go SFP+
- 2 x 25 Go SFP+

REMARQUE :

- Vous pouvez installer jusqu'à deux cartes NIC PCIe complémentaires.
- Pour plus d'informations sur les paramètres de performances du réseau Linux, voir le *Linux Network Tuning Guide for AMD EPYC Processor Based Servers (Guide de réglage d'un réseau Linux pour serveurs munis de processeurs AMD EPYC)* sur [AMD.com](https://www.amd.com).

Caractéristiques du connecteur série

Le système PowerEdge R6515 prend en charge un connecteur série sur le panneau arrière, de type DTE (Data Terminal Equipment) à 9 broches conforme à la norme 16550.

Caractéristiques des ports VGA

Le système PowerEdge R6515 prend en charge deux ports VGA à 15 broches sur les panneaux avant et arrière.

IDSDM

Le système PowerEdge R6515 prend en charge le module SD interne double (IDSDM) avec la capacité de stockage suivante :

- 16 Go
- 32 Go
- 64 Go

REMARQUE : Un logement de carte IDSDM est réservé à la redondance.

REMARQUE : Utilisez des cartes microSD de marque Dell EMC associées aux systèmes configurés IDSDM.

Spécifications vidéo

Le système PowerEdge R6515 prend en charge le contrôleur graphique Matrox G200eR2 intégré avec 16 Mo de mémoire tampon vidéo.

Tableau 11. Options de résolution vidéo avant prises en charge

Résolution	Taux d'actualisation (Hz)	Profondeur de couleur (bits)
1 024 x 768	60	8, 16, 32
1 280 x 800	60	8, 16, 32
1 280 x 1 024	60	8, 16, 32
1 360 x 768	60	8, 16, 32
1 440 x 900	60	8, 16, 32

Tableau 12. Options de résolution vidéo arrière prises en charge

Résolution	Taux d'actualisation (Hz)	Profondeur de couleur (bits)
1 024 x 768	60	8, 16, 32
1 280 x 800	60	8, 16, 32
1 280 x 1 024	60	8, 16, 32
1 360 x 768	60	8, 16, 32
1 440 x 900	60	8, 16, 32
1 600 x 900	60	8, 16, 32
1 600 x 1 200	60	8, 16, 32
1 680 x 1 050	60	8, 16, 32
1 920 x 1 080	60	8, 16, 32
1 920 x 1 200	60	8, 16, 32

Spécifications environnementales

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les certifications environnementales, veuillez consulter la *Product Environmental Datasheet (Fiche technique environnementale du produit)* qui se trouve dans la section Manuels et documents sur <https://www.dell.com/support>.

Plages climatiques opérationnelles de catégorie A2

Tableau 13. Plages climatiques opérationnelles de catégorie A2

Opérations continues autorisées	
Plages de températures pour une altitude \leq à 900 mètres (\leq 2 953 pieds)	De 10 °C à 35 °C (de 50 °F à 95 °F) sans lumière directe du soleil sur la plate-forme
Plages de pourcentages d'humidité (sans condensation en permanence)	De 8 % d'humidité relative, avec un point de condensation minimale de -12 °C, à 80 % d'humidité relative, avec un point de condensation maximale de 21 °C (69,8 °F)
Déclassement de l'altitude opérationnelle	Réduction de la température maximale de 1 °C/300 mètres (1,8 °F/984 pieds) au-dessus de 900 mètres (2 953 pieds)

Plages climatiques opérationnelles de catégorie A3

Tableau 14. Plages climatiques opérationnelles de catégorie A3

Opérations continues autorisées	
Plages de températures pour une altitude \leq à 900 mètres (\leq 2 953 pieds)	De 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F) sans lumière directe du soleil sur la plate-forme
Plages de taux d'humidité (sans condensation permanente)	De 8 % d'humidité relative, avec un point de condensation minimale de -12 °C, à 85% d'humidité relative, avec un point de condensation maximale de 24°C (75,2°F)
Déclassement de l'altitude opérationnelle	Réduction de la température maximale de 1 °C/175 mètres (1,8 °F/574 pieds) au-dessus de 900 mètres (2 953 pieds)

Exigences partagées par toutes les catégories

Tableau 15. Exigences partagées par toutes les catégories

Opérations autorisées	
Gradient de température maximal (en fonctionnement et à l'arrêt)	20 °C en une heure* (36 °F en une heure) et 5 °C en 15 minutes (9 °F en 15 minutes), 5 °C en une heure* (9 °F en une heure) pour le matériel de bande
Limites de température à l'arrêt	De -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Limites d'humidité à l'arrêt	5 % à 95 % d'humidité relative et point de condensation maximal de 27°C (80,6°F)
Altitude de stockage maximale	12 000 mètres (39 370 pieds)
Altitude de fonctionnement maximale	3 048 mètres (10 000 pieds)

* : selon les instructions thermiques de l'ASHRAE, il n'y a pas de taux instantanés de modification de la température.

Tableau 16. Caractéristiques de vibration maximale

Vibration maximale	Spécifications
En fonctionnement	0,26 G _{rms} de 5 à 350 Hz (toutes orientations de fonctionnement)
Stockage	1,88 G _{rms} de 10 à 500 Hz pendant 15 min (les six côtés testés)

Tableau 17. Spécifications d'onde de choc maximale

Onde de choc maximale	Spécifications
En fonctionnement	24 chocs consécutifs de 6 G en positif et en négatif sur les axes x, y et z pendant un maximum de 11 ms (4 impulsions de chaque côté du système).
Stockage	6 chocs consécutifs de 71 G en positif et en négatif sur les axes x, y et z pendant un maximum de 2 ms (1 impulsion de chaque côté du système).

Caractéristiques de contamination de particules et gazeuse

Le tableau suivant définit les limitations qui permettent d'éviter les dommages et/ou les pannes d'équipement informatique causés par une contamination particulaire ou gazeuse. Si les niveaux de contamination particulaire ou gazeuse dépassent les limites indiquées et causent des dommages ou une panne d'équipement, vous devez rectifier les conditions environnementales. La modification de ces conditions environnementales relève de la responsabilité du client.

Tableau 18. Caractéristiques de contamination particulaire

Contamination particulaire	Spécifications
Filtration de l'air	<p>Filtration de l'air du datacenter telle que définie par ISO Classe 8 d'après ISO 14644-1 avec une limite de confiance maximale de 95%.</p> <p>i REMARQUE : Cette condition s'applique uniquement aux environnements de datacenter. Les exigences de filtration d'air ne s'appliquent pas aux équipements IT conçus pour être utilisés en dehors d'un datacenter, dans des environnements tels qu'un bureau ou en usine.</p> <p>i REMARQUE : L'air qui entre dans le datacenter doit avoir une filtration MERV11 ou MERV13.</p> <p>i REMARQUE : Le filtrage de l'air peut également être effectué en filtrant l'air de la salle à l'aide d'un filtre MERV8 conformément à la norme ANSI/ASHARE 127.</p>
Poussières conductrices	<p>L'air doit être dépourvu de poussières conductrices, barbes de zinc, ou autres particules conductrices.</p> <p>i REMARQUE : Cette condition s'applique aux environnements avec et sans datacenter.</p> <p>i REMARQUE : Les sources courantes de poussières conductrices comprennent les processus de fabrication et les barbes de zinc provenant du revêtement métallique sur la partie inférieure des dalles surélevées.</p>
Poussières corrosives	<ul style="list-style-type: none"> L'air doit être dépourvu de poussières corrosives. Les poussières résiduelles présentes dans l'air doivent avoir un point déliquescent inférieur à une humidité relative de 60%. <p>i REMARQUE : Cette condition s'applique aux environnements avec et sans datacenter.</p>

Tableau 19. Caractéristiques de contamination gazeuse

Contamination gazeuse	Spécifications
Vitesse de corrosion d'éprouvette de cuivre	<300 Å/mois selon la Classe G1 telle que définie par ANSI/ISA71.04-2013
Vitesse de corrosion d'éprouvette d'argent	< à 200 Å/mois conformément à la norme ANSI/ISA71.04-2013.

i **REMARQUE :** Niveaux de contaminants corrosifs maximaux mesurés à ≤50% d'humidité relative.

Tableau des restrictions thermiques

Tableau 20. Tableau des restrictions thermiques pour le processeur et les ventilateurs

Configuration	4 disques de 3,5 pouces	8 disques de 2,5 pouces	10 disques de 2,5 pouces (NVMe)
TDP du processeur			
120 W	Ventilateur STD Dissipateur de chaleur STD	Ventilateur STD Dissipateur de chaleur STD	Ventilateur HPR* Dissipateur de chaleur STD
155 W	Ventilateur STD Dissipateur de chaleur STD	Ventilateur STD Dissipateur de chaleur STD	Ventilateur HPR* Dissipateur de chaleur STD

Tableau 20. Tableau des restrictions thermiques pour le processeur et les ventilateurs (suite)

Configuration	4 disques de 3,5 pouces	8 disques de 2,5 pouces	10 disques de 2,5 pouces (NVMe)
TDP du processeur			
180 W	Ventilateur STD Dissipateur de chaleur HPR	Ventilateur STD Dissipateur de chaleur HPR	Ventilateur HPR* Dissipateur de chaleur HPR
200 W	Ventilateur STD Dissipateur de chaleur HPR	Ventilateur STD Dissipateur de chaleur HPR	Ventilateur HPR* Dissipateur de chaleur HPR
225 W	Ventilateur HPR Dissipateur de chaleur HPR	Ventilateur HPR Dissipateur de chaleur HPR	Ventilateur HPR* Dissipateur de chaleur HPR
240 W	Ventilateur HPR Dissipateur de chaleur HPR	Ventilateur HPR Dissipateur de chaleur HPR	Ventilateur HPR* Dissipateur de chaleur HPR
280 W	Ventilateur HPR HSK HPR avec cache de module DIMM	Ventilateur HPR HSK HPR avec cache de module DIMM	Non pris en charge
280 W - 64C/32C	Ventilateur HPR HSK HPR avec cache de module DIMM	Ventilateur HPR HSK HPR avec cache de module DIMM	Non pris en charge

REMARQUE : * La température ambiante prise en charge est 30 °C.

REMARQUE : Pour assurer le refroidissement correct du système doté d'un processeur 280 W, vous devez installer un cache de module DIMM dans chaque socket de mémoire vacant.

REMARQUE : Pour le processeur 280 W, la température ambiante maximale prise en charge est de 35 °C.

REMARQUE : Pour 10 disques NVMe de 2,5 pouces, la température ambiante maximale prise en charge est de 30 °C.

Tableau 21. Tableau des restrictions thermiques pour la carte GPGPU T4

Configurations de la carte de montage	Type de configuration et prise en charge de la température ambiante		
	4 disques de 3,5 pouces	8 disques de 2,5 pouces	10 disques de 2,5 pouces (NVMe)
	2 LP	2 LP	2 LP
	Température ambiante : 30 °C		
Logement 2	Ventilateur HPR	Ventilateur HPR	S/O
Logement 3	Ventilateur HPR	Ventilateur HPR	Ventilateur HPR + disques NVMe dans les logements 6 à 9 + disques SAS ou SATA dans les logements 0 à 5

Tableau 22. Référence des libellés

Étiquette	Description
STD	Standard
HPR	Hautes performances
HSK	Dissipateur de chaleur
Demi-hauteur	Profil bas

Restrictions thermiques des normes environnementales de l'ASHRAE pour la classe A3/ Fresh Air

- Les processeurs ayant une enveloppe thermique supérieure ou égale à 180 W ne sont pas pris en charge.
- Les modules LRDIMM d'une capacité de 128 Go ou plus ne sont pas pris en charge.
- Une configuration d'alimentation redondante est requise, mais la panne de bloc d'alimentation n'est pas prise en charge.
- Les cartes de périphériques non homologuées Dell ou les cartes de périphériques supérieures à 25 W ne sont pas prises en charge.
- Carte du processeur graphique non prise en charge.
- Les disques SSD PCIe ne sont pas pris en charge.

Restrictions thermiques des normes environnementales de l'ASHRAE pour la classe A4/ Fresh Air

- Les processeurs ayant une enveloppe thermique supérieure ou égale à 155 W ne sont pas pris en charge dans la classe A4.
- Les barrettes LRDIMM d'une capacité de 128 Go ou plus ne sont pas prises en charge dans la classe A4.
- En mode redondant, deux blocs d'alimentation sont nécessaires et les pannes de bloc d'alimentation ne sont pas prises en charge.
- Les cartes de périphériques non homologuées par Dell et/ou les cartes de périphériques supérieures à 25 W ne sont pas prises en charge.
- Le processeur graphique n'est pas pris en charge dans la classe A4.
- Le disque SSD PCIe n'est pas pris en charge dans la classe A4.
- La carte OCP 25 G n'est pas prise en charge dans la classe A4.

Autres restrictions thermiques

1. Les cartes SolarFlare, Mellanox CX4/CX5/CX6, P4800 AIC peuvent uniquement prendre en charge une température ambiante allant jusqu'à 35 °C.
2. La carte Mellanox CX6 sur une configuration à 10 disques de 2,5 pouces peut uniquement être placée sur le logement 3.
3. La carte OCP 25 G ne prend pas en charge les modules LRDIMM de 128 Go sur une configuration à 10 disques de 2,5 pouces.
4. Le ventilateur HPR est requis avec un module LRDIMM de 128 Go.
5. La carte GPGPU T4 ne prend pas en charge les modules LRDIMM de 128 Go.
6. La carte GPGPU T4 prend en charge une température ambiante allant jusqu'à 30 °C avec des ventilateurs HPR et des configurations à 4 disques de 3,5 pouces ou 8 disques de 2,5 pouces.
7. La carte GPGPU T4 prend en charge une température ambiante allant jusqu'à 30 °C avec un ventilateur HPR et une configuration à 10 disques NVMe de 2,5 pouces (logements 6 à 9) et des disques SAS ou SATA (logements 0 à 5) dans le logement 3 uniquement.